****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |



*Text und Foto verfügbar:* [*https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html*](https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html)

Pressemitteilung

congatec präsentiert die 8. Generation der Intel® Core™ Mobile Prozessoren
auf Embedded Formfaktoren

**Consumer-BGA-Prozessoren auf hochwertigen Embedded Boards**

* Eröffnet neue Applikationsfelder
* Unterstützt First-to-Market Strategien

**Deggendorf/Nürnberg, 26. Februar 2019 \* \* \*** congatec – ein führender Anbieter standardisierter und kundenspezifischer Embedded Computer Boards und Module – präsentiert auf der Embedded World 2019 die weltweit ersten[[1]](#endnote-1) Embedded Formfaktoren mit der brandneuen 8. Generation der Intel® Core™ Mobile Prozessoren (Codename Whiskey Lake). Mit dem Launch der COM Express Type 6 Compact Module, 3,5 Zoll SBCs und Thin Mini-ITX Motherboards – alle mit den Intel® Core™ i7-8565U Mobile Consumer Prozessoren – übernimmt congatec eine Vorreiterrolle beim Rollout dieser neuen Prozessorgeneration für raues und platzbeschränktes Umfeld. OEM-Kunden erhalten dadurch frühzeitig Zugang zu dieser neuen High-End Prozessortechnologie und profitieren von First-to-Market Strategien. Endkunden in der Industrie profitieren von einem sofortigen Performanceboost von bis zu 40 % im Vergleich zu den bisherigen Prozessoren der U-Series, ermöglicht durch nun 4 anstelle von lediglich 2 Cores und einer insgesamt verbesserten Mikroarchitektur.

"Eines unserer Hauptziele ist, den Einsatz von Embedded-Computer-Technologie für unsere Kunden so einfach wie möglich zu machen. Deshalb bieten wir unsere Embedded Computer-on-Modules, 3,5 Zoll SBCs und Thin Mini-ITX Mainboards jetzt auch mit Cosnumer-BGA-Varianten der 8. Generation der Intel® Core™ Prozessoren an. Dies hilft OEMs, die neueste Prozessortechnologien schnellstmöglich einsetzen wollen – insbesondere im mobilen High-Performancebereich, wo die Lebenszyklen kürzer sind und OEMs nach komplementären Embedded-Computing-Plattformen suchen, um beispielsweise das Closed-Loop Manufacturing mit aktuellsten Performanceklassen umzusetzen. Unsere neuen Embedded Boards erfüllen genau diesen Bedarf", erklärt Christian Eder, Director of Marketing bei congatec.

Grundsätzlich liefern die neuen Prozessoren die wesentlichen Grundlagen für die Entwicklung von Embedded-Varianten einer neuen Mikroarchitektur-Generation. Sie sind zudem früher am Markt erhältlich als die Embedded Varianten. Gegenüber den Embedded Varianten fehlt den Consumer-Prozessoren im Wesentlichen nur die Langzeitverfügbarkeit – die aber im Embedded High-Performance Rennen oft nicht an erster Stelle steht. OEM Kunden, denen das ausreicht, die aber robuste Embedded Formfaktoren benötigen, sind somit bestens mit diesen hybriden Embedded 3,5 Zoll SBCs, Thin Mini-ITX Motherboards und COM Express Type 6 Modulen bedient, da sie die Vorteile der Consumer-Prozessoren mit denen von robusten Embedded Boards und Modulen kombinieren. Dank identischer APIs von den Embedded Boardherstellern profitieren selbst Anbieter, die in ihrer Serienproduktion die Embedded Varianten einsetzen wollen, von diesen Boards, da sie ihre Applikationen viel früher als sonst auf passenden Plattformen testen können.

**Das Featureset im Detail**

Die neuen hybriden Embedded 3,5 Zoll SBCs conga-JC370, Thin Mini-ITX Motherboards conga-IC370 und COM Express Type 6 Module conga-TC370 sind mit dem 1,8 GHz Intel® Core™ i7-8565U Mobile Quadcore Prozessor bestückt und beeindrucken durch einen Performancezuwachs von bis zu 40% im Vergleich zu den vorherigen U-Series Prozessoren. Ermöglicht wird diese enorme Leistungssteigerung durch den Sprung von 2 auf 4 Cores zusammen mit der verbesserten Mikroarchitektur. Auch der Arbeitsspeicher wurde diesem Leistungsschub entsprechend angepasst: So stehen zwei DDR4 SODIMM Sockel mit bis zu 2400 MT/s für bis zu 64GB zur Verfügung. Zum ersten Mal wird auch USB 3.1 Gen2 vom Prozessor nativ unterstützt. Dieses USB SuperSpeed+ Interface unterstützt eine Datenrate von bis zu 10 Gbit/s, sodass sogar unkomprimierte UHD-Videos von einer Kamera auf einen Monitor übertragen werden können. Der neue 3,5 Zoll SBC stellt diese Performance über einen USB-C Konnektor zur Verfügung, der auch DisplayPort++ sowie die Stromversorgung für Peripheriegeräte unterstützt. Ein Monitor kann so mit lediglich einem einzigen Kabel für DP, Touch und Stromversorgung angeschlossen werden. Die COM Express Module unterstützen diese Features über das Carrierboard. Die weiteren Schnittstellen hängen vom Formfaktor ab; alle unterstützen jedoch insgesamt 3 unabhängige 60 Hz UHD-Displays mit bis zu 4096x2304 Pixel sowie 2x Gigabit Ethernet (1x mit TSN-Support). Die neuen Boards und Module bieten diese und noch viele weitere Interfaces bei einer sparsamen TDP von 15 W, die von 10 W (800 MHz) bis 25 W (bis zu 4,6 GHz im Turbo Boost Modus) skalierbar ist.

Weitere Informationen zum neuen 3,5 Zoll SBC conga-JC370 unter: <https://www.congatec.com/de/produkte/35-sbc/conga-jc370.html>

Weitere Informationen zum neuen Thin Mini-ITX Motherboard conga-IC370 unter: <https://www.congatec.com/de/produkte/mini-itx/conga-ic370.html>

Weitere Informationen zum neuen COM Express Type 6 Computer-on-Module conga-TC370 unter: <https://www.congatec.com/de/produkte/com-express-type-6/conga-tc370.html>

**Über congatec**

congatec ist ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und Customizing-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Core sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*

1. Soweit bekannt [↑](#endnote-ref-1)